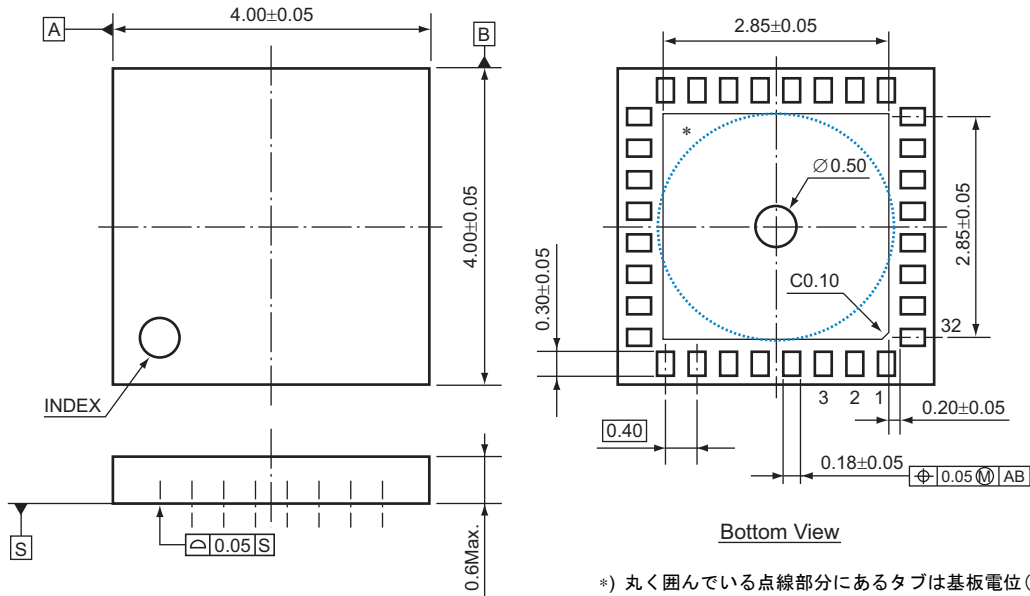


QFN(PLP)0404-32

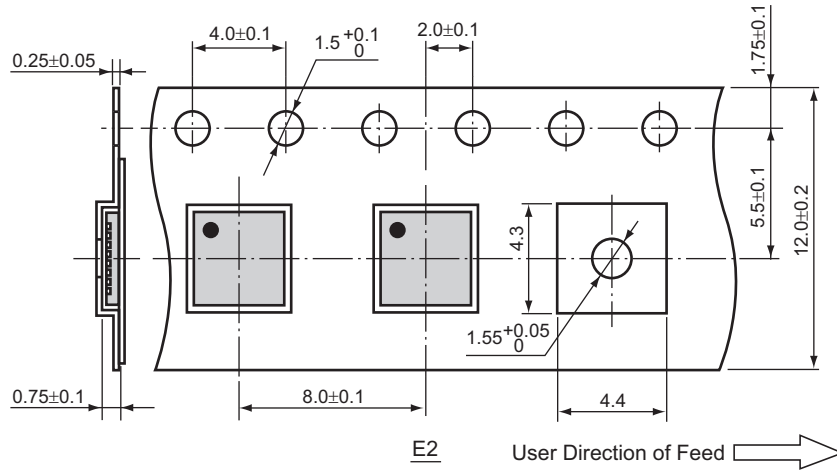
(単位: mm)

■ パッケージ外形図



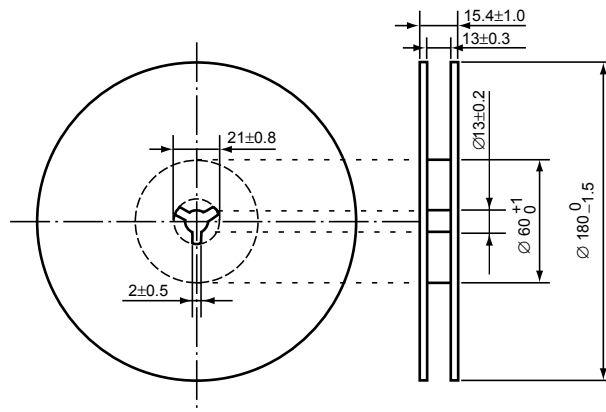
*) 丸く囲んでいる点線部分にあるタブは基板電位 (V_{DD} または GND) です。V_{DD} 端子または GND 端子と接続する (推奨) か、オープンとしてください。

■ テーピング仕様



■ テーピングリール外形図 リュースリール (EIAJ-RRM-12Bc)

(1 リール=2000 個)



■ 許容損失について (QFN(PLP)0404-32)

QFN(PLP)0404-32パッケージの許容損失について特性例を示します。

なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

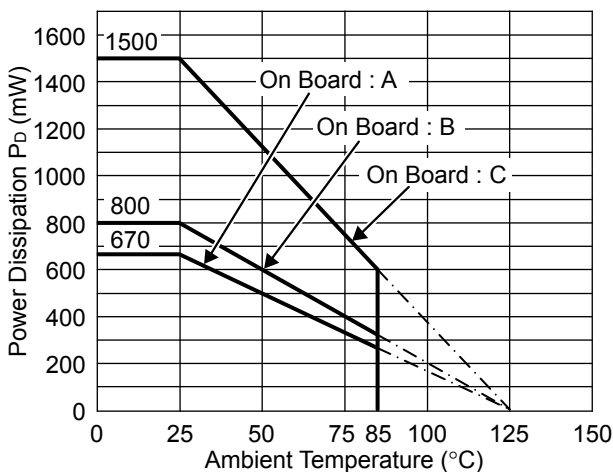
測定条件

	A基板実装条件	B基板実装条件	C基板実装条件
測定状態	基板実装状態 (風速 0m/s)		
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (両面基板)		
基板サイズ	40mm × 40mm × 1.6mm		
配線率	表面 約50%、裏面 約50%	表面 約90%、裏面 約90%	表面 約50%、裏面 約100%
スルーホール	直径0.25mm × 24個	直径0.25mm × 24個	直径0.25mm × 33個
備考	—	—	タブと裏面パターンを直径0.25mmのスルーホール9個で接続

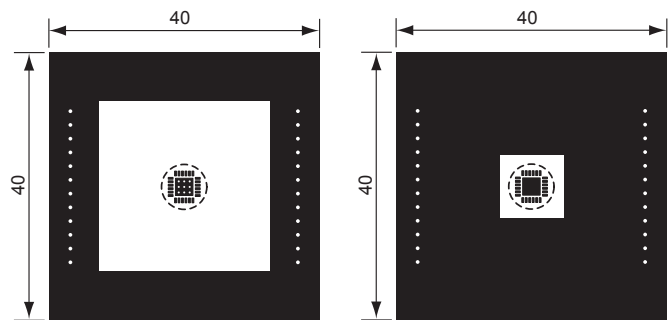
測定結果

(Topt=25°C, Tjmax=125°C)

	A基板実装条件	B基板実装条件	C基板実装条件
許容損失	670mW	800mW	1500mW
熱抵抗値	$\theta_{ja} = 150^\circ\text{C/W}$	$\theta_{ja} = 125^\circ\text{C/W}$	$\theta_{ja} = 67^\circ\text{C/W}$
	$\theta_{jc} = 15^\circ\text{C/W}$		



許容損失特性

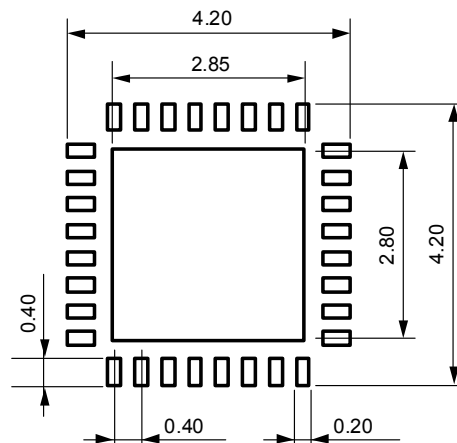


* 内のスルーホール 9 個は C 基板のみ

測定用基板レイアウト

○ IC 実装位置 (単位: mm)

■ 基板パッド推奨寸法 (QFN(PLP)0404-32)



(単位: mm)